



证券代码：002213

证券简称：大为股份

公告编号：2021-006

深圳市大为创新科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

深圳市大为创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 11 月 23 日召开的第五届董事会第六次会议、2020 年 12 月 10 日召开的 2020 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司为子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司为子公司提供担保额度总计不超过 10,000 万元，其中向资产负债率为 70% 以上的担保对象提供的担保额度不超过 3,500 万元。担保范围包括但不限于申请综合授信、借款、融资租赁等融资或开展其他日常经营业务等；担保种类包括保证、抵押、质押等。详情参见公司于 2020 年 11 月 24 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司为子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2020-093）及相关公告。

二、担保进展情况

公司控股子公司深圳市芯汇群微电子技术有限公司（以下简称“芯汇群”）与交通银行股份有限公司深圳分行（以下简称“交通银行深圳分行”）签订了《流动资金借款合同》，借款金额为人民币 1,000 万元。公司与交通银行深圳分行签订了《保证合同》，为上述借款提供连带责任保证。

上述担保事项在公司第五届董事会第六次会议和 2020 年第三次临时股东大会审议通过的担保额度范围内，无需再次提交董事会或股东大会审议。

三、被担保人基本情况

- 1、名称：深圳市芯汇群微电子技术有限公司
- 2、成立日期：2011 年 3 月 23 日

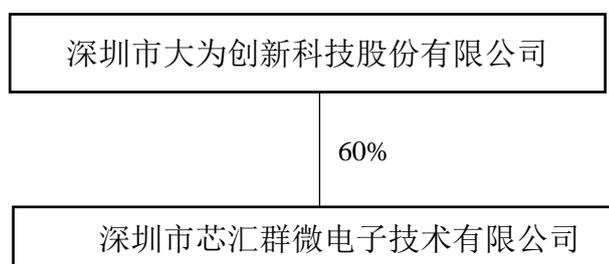
3、注册地点：深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道 5022 号联合广场 A 座 3712、2804、4003-4005

4、法定代表人：连浩臻

5、注册资本：3,000 万人民币

6、主营业务：半导体电子产品测试、晶圆测试，半导体电子产品的生产加工及销售（凭深福环批【2013】400019 号批复生产）；集成电路、混合集成电路、新型电子元器件、电力电子器件及软件的技术开发；国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须批准的项目除外）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可证后方可经营）。

7、股权结构图：



8、与公司关系：芯汇群为公司直接持股 60% 的控股子公司。

9、主要财务指标：

单位：人民币元

项目名称	2020 年 9 月 30 日财务状况（未经审计）	2019 年 12 月 31 日财务状况（经审计）
资产总额	105,517,629.56	73,898,241.84
负债总额	84,076,714.72	58,663,384.69
或有事项涉及的总额	-	-
净资产	21,440,914.84	15,234,857.15
营业收入	111,036,791.05	19,903,417.8
利润总额	6,206,057.69	-1,957,999.18
净利润	6,206,057.69	-1,957,999.18

10、深圳市芯汇群微电子有限公司不属于失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

(一) 公司与交通银行深圳分行签订的《保证合同》主要内容:

- 1、保证人: 深圳市大为创新科技股份有限公司
- 2、债权人: 交通银行股份有限公司深圳分行
- 3、被担保的债务人: 深圳市芯汇群微电子有限公司
- 4、保证方式: 连带责任保证

5、保证范围: 保证的范围为全部主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。实现债权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费(或仲裁费)、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其它费用。

6、保证期间根据主合同约定的各笔主债务的债务履行期限(开立银行承兑汇票/信用证/担保函项下, 根据债权人垫付款项日期)分别计算。每一笔主债务项下的保证期间为, 自该笔债务履行期限届满之日(或债权人垫付款项之日)起, 计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日(或债权人垫付款项之日)后三年止。

债权人与债务人约定债务人可分期履行还款义务的, 该笔主债务的保证期间按各期还款义务分别计算, 自每期债务履行期限届满之日(或债权人垫付款项之日)起, 计至全部主合同项下最后到期的主债务履行期限届满之日(或债权人垫付款项之日)后三年止。

债权人宣布任一笔主债务提前到期的, 该笔主债务的履行期限届满日以其宣布的提前到期日为准。

(二) 被担保方其他股东提供反担保的《反担保保证书》:

芯汇群其他股东赣州敏桂信息产业中心(有限合伙)、赣州华佳信息产业中心(有限合伙)同意以反担保保证人的身份向公司提供连带责任保证反担保。担保的范围包括公司因担保而代芯汇群向交通银行深圳分行偿付的本金、由此产生的利息、违约金、损害赔偿金以及公司承担担保责任所支出的其他费用, 公司代偿后应向芯汇群追偿的本金、利息、违约金及各项费用等, 以及公司代偿后芯汇群延期偿还代偿款而应支付的利息、罚息、违约金、赔偿金、各项费用等。保证期间为自本反担保保证书生效之日起至公司代芯汇群向债权人偿还担保债务之日后两年。

五、累计担保数量及逾期担保的数量

公司对合并报表范围内的子公司提供担保的额度为总计不超过 10,000 万元，其中向资产负债率为 70% 以上的担保对象提供的担保额度不超过 3,500 万元，向芯汇群提供的担保额度不超过 3,000 万元。

截至本公告披露日，公司为子公司提供担保额度总余额为 7,700 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 20.92%；向资产负债率为 70% 以上的担保对象提供的担保额度余额为 1,200 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 3.26%。本次担保前，公司为芯汇群提供的担保金额为 1,300 万元，芯汇群可用担保额度余额为 1,700 万元；本次担保后，公司为芯汇群提供的担保金额为 2,300 万元（含本次），芯汇群可用担保额度余额为 700 万元。公司及子公司无对合并报表外单位提供担保的情形，对应担保额度及余额均为 0；公司及子公司无逾期债务情形，对应的担保额度及余额均为 0；无涉及诉讼的担保金额及因被判决败诉而应承担的担保情形，对应的担保金额为 0。

六、备查文件

- 1、公司与交通银行深圳分行签订的《保证合同》；
- 2、芯汇群与交通银行深圳分行签订的《流动资金借款合同》；
- 3、芯汇群其他股东签署的《反担保保证书》。

特此公告。

深圳市大为创新科技股份有限公司

董 事 会

2021 年 1 月 29 日